

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动纪要

2023年10月

投资者关系 活动类别	2023年第三季度业绩交流会
参与单位	【广发证券】【民生证券】【中金公司】【招商证券】【华泰证券】【中泰证券】【中信证券】【华夏基金】【银河基金】【泓德基金】【万家基金】【银华基金】【交银施罗德基金】【博时基金】【国泰基金】【兴证全球】【华安基金】【中国人寿资管】【中再资产】【上海混沌投资】等机构，总计【419】人。
时 间	2023年10月28日
沟通方式	在线沟通
地 点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	总经理：吴建刚；销售副总裁：冷爱国；董事会秘书：李淑环
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司2023年第三季度报告于2023年10月28日依法披露，公司于2023年10月28日晚以线上方式召开了2023年第三季度业绩交流会，就2023年三季度经营情况与投资者作了进一步交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p><b>一、2023年前三季度及第三季度经营情况介绍</b></p> <p>（一）2023年前三季度经营情况</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入8.13亿元，同比下降44.63%；实现归母净利润为1630.44万元，同比下降94.11%；扣非归母净利润为-4929.99万元。剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为2,545万元，同比下降95.19%。</p> <p>2023年前三季度，公司信号链芯片实现销售收入6.49亿元，同比下降37.33%；电源管理芯片产品实现销售收入1.61亿元，同比下降62.94%。2023年前三季度，公司信号链芯片收入占比为79.78%，电源管理芯片收入占比为</p>

19.75%。

2023 年前三季度，公司信号链芯片产品毛利率为 55.19%，较上年同期减少 6.95 个百分点；电源管理芯片产品毛利率为 47.20%，较上年同期减少 2.64 个百分点。2023 年前三季度，公司综合毛利率为 53.58%，较上年同期减少 4.93 个百分点，主要系部分产品降价及产品结构调整所致。

2023 年前三季度，公司研发投入金额为 3.77 亿元，同比下降 24.60%，约占当期营业收入的 46.41%，主要系摊销的股份支付费用减少所致。截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发技术人员数量增加至 553 人，占公司员工总数 70.36%。

## （二）2023 年第三季度经营情况

2023 年第三季度，公司实现营业收入 2.01 亿元，同比下降 57.25%；实现归母净利润为 221.67 万元，同比下降 94.71%；扣非归母净利润为-1959.74 万元。剔除股份支付费用影响后，归母净利润为-3,050 万元。

2023 年第三季度，公司信号链芯片实现销售收入 1.68 亿元，同比下降 50.29%；电源管理芯片产品实现销售收入 0.33 亿元，同比下降 75.05%。2023 年第三季度，公司信号链芯片收入占比为 83.60%，电源管理芯片收入占比为 16.40%。

## 二、投资者交流主要内容

本次交流会上，公司主要就以下问题与投资者进行了沟通：

### **Q1：请分享下未来公司的核心成长逻辑**

**公司回复：**下面主要从产品线扩展和产业链布局两个方面做一些分享：

第一，在产品线拓展方面，公司将长期围绕泛通讯、泛工业、汽车三大市场进行产品布局。一方面继续坚持平台化扩展路径，持续丰富信号链、电源通用产品矩阵，缩小与国际友商的差距。同时，加快壮大 MCU 产品线，扩大产品覆盖广度，实现模拟与 MCU 业务协同；另一方面，筛选并围绕上述市场中的部分重点细分应用方向，与龙头客户加强战略合作，持续开发满足客户需求的差异化、定制化产品，增强客户黏性，提升在客户端的差异化服务价值和产品组合壁垒。

第二，在产业链协同方面，近两年公司持续夯实产品设计能力的同时，也在以下方面积极探索产业链协作及能力延伸。首先，在晶圆方面，公司持续推进国产供应链建设，致力于打造国内与海外双循环的晶圆供应体系，并与相关伙伴紧

密合作，布局 COT 自有晶圆工艺平台。自有工艺平台建设的推进和在产品端的陆续应用，将有望在成本优化和关键性能提升等方面全面增强产品竞争力；其次，公司在持续加强归一化芯片封装平台的建设和管理，并和供应商一起联合开展相应的封装工艺平台的研发，以助力封装质量管控和成本控制；最后，在自有测试能力建设方面，公司在苏州的自有测试厂建设顺利推进中，将在 2023 年年底前后投入试运营。苏州测试厂将主要针对对可靠性要求高、测试成本占比高且测试复杂度高的产品提供测试服务，降低测试成本，提升产品竞争力。

**Q2：请介绍第三季度产品价格变动情况及未来价格端和成本端变动趋势**

**公司回复：**第三季度公司信号链与电源管理产品平均销售单价同环比均有所下滑，与公司为维护市场份额或加快新产品拓展而实施的主、被动的价格调整有一定关系。降价压力未来短期还会延续，但有望逐步收窄，公司也将持续关注；成本方面，经过与相关合作方的商谈，晶圆和封测成本仍会有一定下降空间，降价效果也会在后续逐步体现出来。

**Q3：请公司更新下目前车规产品研发及市场拓展进展**

**公司回复：**截至目前，公司已量产车规产品近 100 颗，产品品类覆盖车规信号链产品（通用/特殊运放、ADC、比较器、数字隔离器与隔离驱动、CAN、LIN、SBC 等）、车规电源产品（LDO、BUCK、PMIC、电压基准、监控和复位 IC、半桥/低边驱动、变压驱动器等）。长远来看，随着汽车电动化与智能化水平的持续提升，模拟芯片在汽车系统的应用机会也会不断增加，公司将保持在汽车市场的资源投入，持续丰富车规产品矩阵，不断提升产品单车价值量。

目前公司已取得国内主要电动车客户（包括一些 Tier1）的供应商资质并展开合作，同时也在积极推进与海外汽车客户及全球 Tier1 的接洽与合作。

**Q4：请介绍下 MCU 产品进展及 MCU 与模拟业务的协同效应**

**公司回复：**公司首款 MCU 产品于 2023 年 5 月中上旬流片回来，目前处于量产推广阶段。首颗芯片功能验证结果满足设计目标，部分指标达到延伸目标。目前公司在和重点客户合作进行应用开发，争取更多的客户导入。后续第 2-4 个产品系列也已进入芯片设计阶段，会围绕工业控制和新能源市场细分应用不断丰富和拓展产品组合。

MCU 与模拟业务的协同效应主要体现在以下两方面：

	<p>第一，产品设计方面的协同。MCU 的竞争力主要体现在目标应用的落地，而应用落地主要靠系统集成(SOC)和 IP。公司基于在模拟方面的深厚积累可以在设计 MCU 的模拟 IP 时，在性能和面积上做出竞争力。同时，数模混合芯片内部数模 SOC 的互联互通对于系统集成的易用性、市场可拓展性、快速迭代至关重要。公司自研 IP 可以根据公司的目标市场，结合 MCU 平台化设计，优化连接接口，兼顾市场的覆盖度和平台快速迭代的需求，做出竞争力。</p> <p>第二，目标应用方案方面的协同。MCU 作为系统的核心主芯片，借助 MCU 产品有利于了解系统的整体需求（包括系统周边各类模拟芯片应用需求）。因此，结合模拟周边的产品线，公司可以给客户提供整体解决方案，简化客户二次开发的周期，缩短量产周期。同时，MCU 在应用迭代的过程中会更好的了解到周边器件的技术需求，通过内部团队协同，也可以帮助模拟芯片设计更全面的了解应用需求，提升产品应用匹配度，更早的规划下一代产品。</p> <p><b>Q5: 请介绍下公司海外布局的最新进展</b></p> <p><b>公司回复:</b>全球模拟半导体市场需求大约 30-40%分布在大中华区，剩余 60%左右分布在美国、欧洲、日本等海外市场。因此，公司在立足中国市场的同时，也会持续加大在海外市场的投入，逐步完善在销售、供应链、人才、研发和知识产权等多个维度的海外布局，为全球化业务拓展做好准备。目前公司已在韩国、新加坡、美国及欧洲等地建立销售团队，相关客户开拓、渠道建设及产品导入等工作也在积极推进中。</p>
日期	2023 年 10 月 31 日